

[KAIST ME 산학협동 공개강좌] 반도체 첨단패키징을 위한 공정 소재, 역학 및 측정기술의 이해와 응용



참가신청서

일시 : 2025.02.03 (월) ~ 06 (목) / 장소 : KAIST 기계공학동 대회의실 (N7 1601호)

* 강좌 설명

본 강좌는 반도체 첨단패키징에서 활용되는 공정, 분석 및 측정 기술에 대한 핵심 원리와 응용방법을 다루는 강좌로 반도체 패키징 설계 및 생산에 필요한 기초 역학 이론을 학습하고, 반도체 패키징 분야의 고도화와 첨단화를 주도하기 위한 공학적 사고 능력을 갖추도록 하는 것을 목표로 함.

* 신청 기간 : ~2025.01.16 (목) 자정

* 수강 정원 : 80명 (정원 마감 시 조기 마감)

* 수강 신청

상단 QR 코드 또는 <https://buly.kr/5fBJaxZ> 으로 접속하여 참가 신청서 제출

* 강사진 : 카이스트 기계공학과 교수 12명



윤용진 교수 - 증착



김산하 교수 - CMP



남동욱 교수 - 하이브리드본딩



김지태 교수 - 3D 배선



김성수 교수 - EMC 경화



김택수 교수 - 박막 신뢰성



김형수 교수 - 미세 유체



남영석 교수 - 열관리



이정철 교수 - 신공정 & 측정



오왕열 교수 - 광학 측정



김영진 교수 - 비파괴 측정



노민균 교수 - 정밀 스테이지

* 수강 대상

산업체, 연구소 및 대학에서 패키징과 관련된 공정, 측정 및 평가 기술의 고도화 및 첨단화에 관심이 있는 자.

* 수강료: 교재비, 증식비 포함

일반 (4일 / 2일)	1,000,000 원 / 600,000 원
학생 (4일 / 2일)	500,000 원 / 300,000 원

* 수강료 납부 방법: 계좌이체, 신용카드, 산학기금 계정대체

1) 계좌이체 (2025년 01월 01일 이후 입금 가능)

- 계좌번호: 우리은행 270-003359-13-137 (한국과학기술원)
- 입금 후 성명/소속명/연락처를 scott@kaist.ac.kr 로 전달

2) 신용카드

- 강좌 당일 카드결제 가능

* 학생 : 재학증명서 사본 제출

* 수익 사업으로 계산서 교부 가능

* 강좌 일정

강의 일자	강의 주제	강사진
1일자 (02.03)	증착 CMP 하이브리드 본딩 공정	윤용진 교수 김산하 교수 남동욱 교수
2일자 (02.04)	3D 배선 인쇄 EMC 경화 공정 박막 신뢰성 평가 기술	김지태 교수 김성수 교수 김택수 교수
3일자 (02.05)	미세 유체역학 제어 솔루션 열관리 공정/측정 신기술	김형수 교수 남영석 교수 이정철 교수
4일자 (02.06)	3차원 초고속 광학 측정 비파괴 측정/검사 정밀 모션 스테이지	오왕열 교수 김영진 교수 노민균 교수

KAIST



문의 : KAIST 김산하 교수
(sanhkim@kaist.ac.kr)